

# 托马斯PI线路板高温胶THOP2

产品名称	托马斯PI线路板高温胶THOP2
公司名称	成都杰欣精锐科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	托马斯:单组份, 热压快速固化 THOP-2:180 ± 5 时1--5分 成都:耐温范围:-65 - +35
公司地址	成都市成华区羊子山路68号5栋2单元13层2号
联系电话	18780207925

## 产品详情

本品系环氧树脂双改性胶粘剂, 单组份, 热压快速固化, 无气泡、无干花、蛇眼、粘接强度高, 耐高温性优良, 干片后质地柔软, 操作简便。适用于PI、铝基、FPC等线路板制作生产制作中用于铝、铜膜、复合材料(玻璃纤维、芳纶、PI、PET、纸张等)的自粘与互粘, 及高温回流焊要求。

- 外观: 为浅色粘稠液体, 无固体颗粒。25 ± 3 粘稠度600-750mps.固含量58.8%, 常温下, 触变形强,
- 固化速度快, 180 ± 5 时1--5分钟固化, 或150 ± 5 1小时固化, 完全冷却后即接近\*\*\*粘接强度。
- 粘接强度高, 耐久、耐紫外光性能优良。
- 耐高温性能好, 适应温度范围广, 粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
- 粘接表面无需严格处理, 使用方便。
- 耐介质性能优良, 耐油、水、酸、煤油、洗版液等。
- 安全及毒性特征: 有极轻微异味, 无吸入\*\*\*, 固化后实际\*\*\*。
- 贮存稳定性较好, 3 贮存期为半年。

主要技术性能指标如下: 耐温范围:-65 - +350

(铝/铝) 粘接强度: 常温: 拉伸强度 25MPa; 剪切强度 20 Mpa 230 : 拉伸强度 2.5 - 4 Mpa

PI(膜20-25um)/铜膜 粘结剥离强度 PI膜\*\*\*坏 回流焊260-288 30-90s合格

- 1、将被复合或被粘接材料表面去污、擦净并烘干。
- 2、将胶液刮涂或喷涂或丝印被粘物表面, 调整烘道或传送带速度, 温度控制在145 ± 5 , 22—60秒钟干片

。

3、干片在相对湿度55% ,  $25 \pm 3$  环境保存期为3-6个月。

4、将干片后的PI膜对应好需披覆的基材，将热压温度控制在 $180 \pm 10$  ,压力3Mpa ,1m固化，缓慢冷却后即可，胶水热压时流动速度及流动角度可调整。

1、操作环境注意通风,排风。

2、胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗。